平成 29 年 1 月吉日

会員各位

平成 28 年度第 2 回計装測定分科会(第 36 回計装測定講演会)

開催のご案内

一般社団法人　日本粉体工業技術協会　計装測定分科会
コーディネータ　同志社大学教授　森 康維
副コーディネータ　岡山大学教授　後藤 邦彰
代表幹事　㈱島津製作所　鷲尾一裕
副代表幹事　㈱セイシン企業　阿川直樹
副代表幹事　スペクトリス㈱　池田英幸

平素は計装測定分科会の活動に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

このたびは、平成 28 年度第 2 回計装測定分科会として、第 36 回計装測定講演会を開催いたします。

今回のテーマは【 **粉粒体物性測定の最新動向－主に粒子径計測以外のアプローチを中心に** 】としております。

多様化する粉体材料の特性を調べるためには粒子径計測だけでは十分ではありません。圧縮強度やせん断力などを含む力学的特性、比表面積や細孔分布などの表面構造など、いろいろな角度から総合的に粉体材料の特性を評価する必要性が増えてきています。今回は、これらの多様な測定法に関連した最新の規格化の動向と、粒子の強度計測の基礎からその重要性、さらにはメカノケミストリーや粉砕プロセスとの関係について、それぞれ造詣の深い先生方に基調講演を行っていただきます。さらに企業講演として、主に計測器メーカから最近の取り組みやアプリケーションをご紹介いただきます。

物性測定の技術動向を知るまたとない機会です。多くの方々にご参加頂きますようご案内申し上げます。

記

1．開催日時 ： 平成 29 年 2 月 2 日(木) 10:30～17:00

2．開催場所 ： 同志社大学東京オフィス　セミナールーム(受付場所も同じ)

〒104-0031 東京都中央区京橋 2 丁目 7 番 19 号 京橋イーストビル 3 階

http://tokyo-office.doshisha.ac.jp/access/map.html

3. プログラム

10:00　開場、受付

10:30－10:40　開会の挨拶　計装測定分科会コーディネータ 同志社大学教授 森 康維 様

10:40－11:30　基調講演 1 『粉体物性測定に関する国際・国内規格化の動向』
技術研究組合 単層 CNT 融合新材料研究開発機構 (TASC)
遠藤 茂寿 様

内容:
・ISO/TC 24/SC 4 を中心とした粉体物性評価に関する国際規格化
・協会が関係しているその他の国際規格化(TC 142, TC 281, TC 229)
・粉体物性評価に関係する国内規格化 ・今後の標準化など

11:30－11:55　企業講演 1 『CB の1次・2次凝集体の総合評価および SI トレーサブルな吸着等温線測定に関する取組』 ﾏｲｸﾛﾄﾗｯｸ・ﾍﾞﾙ㈱ 吉田 将之 様

11:55－13:15　休憩

13:15－14:05　基調講演２　『粉砕における粒子強度計測の位置づけ』

東北大学　名誉教授　齋藤　文良　様

内容:

・はじめに、粉砕と固体の強度の関わり

・粒子の強度の定義～理想的強度。実測強度は、何故理想的強度より極端に低いのか？

・実測強度は測定条件に依存。寸法効果（～波及効果は、粉砕限界）、雰囲気の影響（波及効果は、粉砕助剤）、荷重速度効果（波及効果は、難粉砕性材料の微粉化）など

・難しい微粒子の強度測定、多くの物質は微粒子になると塑性変形（延性化する）。粉砕では、付着・凝集、メカノケミカル効果の発現

・結びとして、材料強度と粉砕現象の理解に添えて

14:05－14:50　企業講演２　『粉体の付着性・流動性の実用的な測定と評価』

㈱ナノシーズ　技術顧問　羽多野　重信　様

内容:

・粉体の基礎物性

・粉体の付着性…付着力と付着性、付着力の測定と評価、付着性の実用的な評価

・粉体の流動性…荷重下の流動性と非荷重下の流動性、流動性の測定と評価、市販装置による実用的な評価　他

14:50－15:05　企業講演３『遠心法付着力測定装置の原理と測定事例のご紹介』

日立工機(株)ライフサイエンス機器事業部　可児　修一　様

15:05－15:15　休憩

15:15－15:40　企業講演４『粉体の物性評価によるトラブル対策及び安定した品質の確保』

㈱セイシン企業　開発部　機器開発課　平　貴幸　様

15:40－16:05　企業講演５『シェアセル法による粉体の流動性評価について』

英弘精機株式会社　テクニカルセンター　新井　武彦　様

16:05－16:30　企業講演６『粉を扱う、見る、計る』

㈱堀場製作所

16:30－16:40　全体討論、質疑応答

16:40－16:50　閉会の挨拶　計装測定分科会副コーディネータ　岡山大学教授　後藤　邦彰　様

17:00　解散

4. 参加定員 ：　50 名

5.　参加費　：　会員 3,000 円、会員外 5,000 円（当日申し受けます）

6. 参加申込み

・次ページの申込書にて下記まで FAX して頂くか、同じ内容を E-mail でお願いいたします。

【E-mail でお申込みいただいた方がより早くお返事することができます。】

・申込締切:　**平成 29 年 1 月 27 日（金）**（定員に達した場合は期日前でも締切ります）

・申込先: 〒604-8511 京都市中京区西ノ京桑原町1　(株)島津製作所　GADC　鷲尾　一裕

FAX　075-841-9326　　(TEL 075-823-1345)

E-mail:　washio_k@shimadzu.co.jp

㈱島津製作所 GADC 鷲尾あて　　**FAX 075-841-9326**

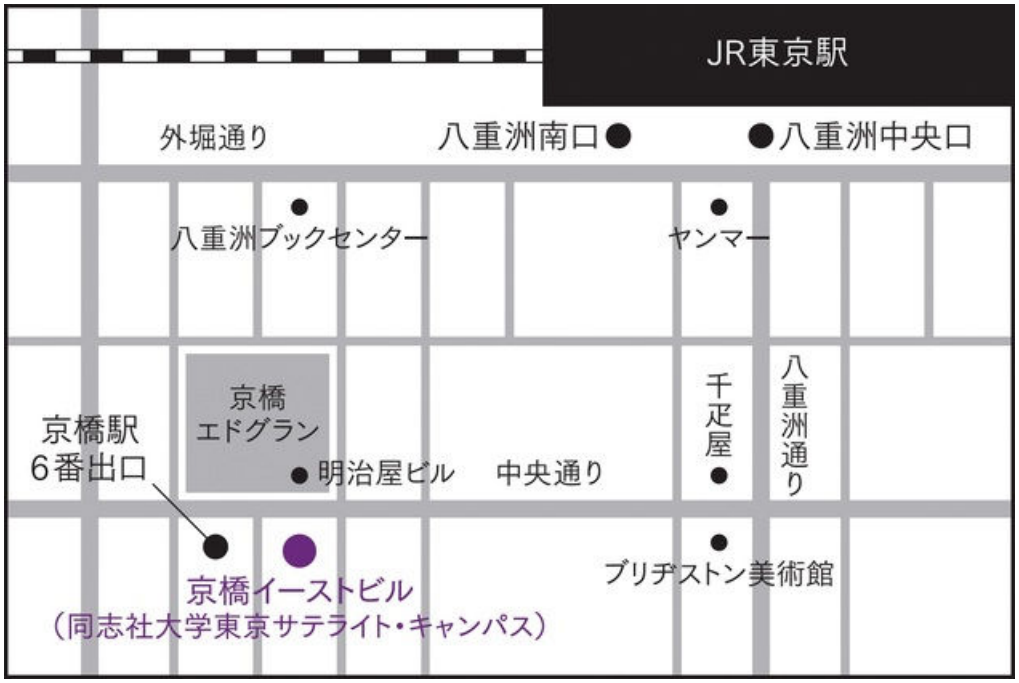
平成 28 年度第 2 回計装測定分科会（第 36 回計装測定講演会）
参加申込書

ご参加者氏名（必須）	
勤務先名称（必須）	
所属部署・役職（必須）	
所在地（必須）　〒＿＿＿＿＿	
連絡先電話	連絡先 FAX
E-mailアドレス（必須）	
会員／非会員の別（必須）　　会　員　／　非会員　（いずれかに○をご記入下さい）	
連絡事項	

本申込書でいただいた個人情報は、本講演会および日本粉体工業技術協会での事務処理以外には使用しません。
E-mail でお申込みいただく場合は、上記の内容を下記アドレスまでお送りください。

アドレス⇒washio_k@shimadzu.co.jp　島津製作所 GADC 鷲尾まで

◎同志社大学　東京オフィスへのアクセス

〒104-0031 東京都中央区京橋 2 丁目 7 番 19 号 京橋イーストビル 3 階

アクセスは下の地図を参考にしてください。1 階にみずほ銀行が入っているビルの 3 階で、『みずほ銀行』横の入口からお入りください。（直接会場までおこし下さい。）